

Gold (Au)

Kupfer (Cu)

Nickel (Ni)

FR4 Material



individualisierte Darstellung

BESCHREIBUNG

Mit der steigenden Nachfrage nach Fein- und Feinstleitern, sowie das immer geringer werden der Packungsdichten von Leiterplatten, steigt auch die Nachfrage an chemischen Oberflächen. Chemisch Gold ist eine sehr plane alternative und hat dabei sehr gute Oxidationseigenschaften. Die Oberfläche chemisch Gold setzt sich zusammen aus 3-5µm Ni/ 0,05-0,1µm AU.

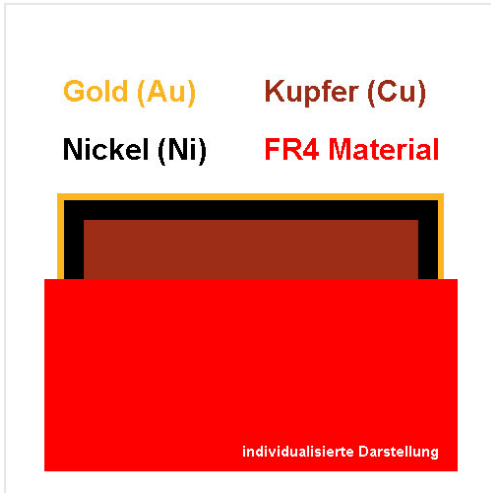
Vorteile:

-
- Gute Lagerfähigkeit (ca. 1 Jahr)
 - Sehr gut für Finepitch
 - Sehr gut für SMD
 - Pads sind plan
 - Sehr gute Benetzung
-

Nachteile:

-
- Teurer als HAL bleifrei
-

FOTOS



DISCLAIMER

In the absence of confirmation by device specification sheets, ES&S Solutions GmbH takes no responsibility for any defects that occur in equipment using any of ES&S's devices, shown in catalogs, data books, etc. Contact ES&S in order to obtain the latest device specification sheets before using any ES&S's device. ES&S reserves the right to make changes in the specifications, characteristics, data, materials, structures and other contents described herein at any time without notice in order to improve design or reliability. Contact ES&S in order to obtain the latest specification sheets before using any ES&S's device. Manufacturing locations are also subject to change without notice. Observe the following points when using any device in this publication. ES&S takes no responsibility for damage caused by improper use of the devices. ES&S's devices shall not be used for equipment that requires extremely high level of reliability, such as: -Military and space applications -Nuclear power control equipment -Medical equipment for life support